

2021-2026年中国晶圆市场竞争策略及行业投资潜力预测报告

报告大纲

一、报告简介

华经情报网发布的《2021-2026年中国晶圆市场竞争策略及行业投资潜力预测报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.huaon.com/channel/semicon/675787.html>

报告价格：电子版: 9000元 纸介版：9000元 电子和纸介版: 9200元

订购电话: 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱: kf@huaon.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

晶圆指制造半导体晶体管或集成电路的衬底（也叫基片）。由于是晶体材料，其形状为圆形，所以称为晶圆。衬底材料有硅、锗、GaAs、InP、GaN等。由于硅最为常用，如果没有特别指明晶体材料，通常指硅晶圆。

在硅晶片上可加工制作成各种电路元件结构，而成为有特定电性功能的集成电路产品。晶圆的原始材料是硅，而地壳表面有用之不竭的二氧化硅。二氧化硅矿石经由电弧炉提炼，盐酸氯化，并经蒸馏后，制成了高纯度的多晶硅，其纯度高达99.999999999%。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 2020年国内外晶圆行业整体运行态势分析

第一节 2020年世界晶圆行业运行总况

- 一、全世界晶圆的产能
- 二、硅片市场的国际化和生产垄断化已经形成
- 三、硅片制造技术进一步升级

第二节 2020年中国晶圆行业的发展形势综述

- 一、中国晶圆稳步发展
- 二、中国晶圆产销回顾

第三节 2020年中国晶圆生产主要地区项目建设动态分析

- 一、涿鹿打造国内最大晶圆生产研发基地
- 二、青海晶圆产业化项目技术取得突破
- 三、亿元晶圆项目入驻杞县
- 四、青海聚阳能硅业年产3500吨晶圆项目开建

第四节 2020年中国硅单晶技术取得的重要进展

- 一、12英寸硅单晶生长技术已经成熟
- 二、有效控制原生颗粒缺陷形成
- 三、12英寸硅单晶抛光片加工技术成熟
- 四、外延优化衬底技术获得发展

第五节 2020年中国晶圆技术及生产设备分析

- 一、中国硅单晶生产设备发展现状
- 二、中国硅单晶生产设备技术取得重大突破
- 三、中国太阳能硅单晶生产设备发展分析

- 1、太阳能硅单晶生产设备销量直线上升
- 2、太阳能硅单晶生产设备发展水平亟待实质性提高

第二章 2020年中国晶圆行业市场发展环解析

第一节 国内宏观经济环境分析

- 一、GDP历史变动轨迹分析
- 二、固定资产投资历史变动轨迹分析
- 三、2020年中国宏观经济发展预测分析

第二节 2020年中国晶圆市场政策环境分析

- 一、晶圆、晶圆片加工贸易单耗标准
- 二、相关行业政策
- 三、法律法规

第三节 2020年中国晶圆市场社会环境分析

第三章 2020年中国晶圆行业市场运行态势剖析

第一节 2020年中国晶圆产业技术研究新进展

- 一、晶圆技术指标分析
- 二、晶圆加工成晶圆抛光硅片工艺流程
- 三、晶圆产业化节能技术取得科技突破

第二节 2020年中国晶圆重点区域市场动态分析

- 一、宜昌南玻成功拉制出直径8英寸晶圆
- 二、肥东获晶圆技术新成果
- 三、榆林光伏产业第一根太阳能级晶圆下线

第三节 2020年中国晶圆产业项目研究

- 一、晶圆、单晶切片生产项目
- 二、晶圆中外合资项目
- 三、晶圆产业招投标分析

第四节 2020年中国晶圆产业热点问题探讨

第四章 2018-2020年中国晶圆制造所属行业数据监测分析

第一节 2018-2020年中国晶圆制造所属行业总体数据分析

- 一、2018年中国晶圆制造所属行业企业数据分析
- 二、2019年中国晶圆制造所属行业企业数据分析
- 三、2020年中国晶圆制造所属行业企业数据分析

第二节 2018-2020年中国晶圆制造所属行业不同规模企业数据分析

- 一、2018年中国晶圆制造所属行业不同规模企业数据分析
- 二、2019年中国晶圆制造所属行业不同规模企业数据分析
- 三、2020年中国晶圆制造所属行业不同规模企业数据分析

第三节 2018-2020年中国晶圆制造所属行业不同所有制企业数据分析

一、2018年中国晶圆制造所属行业不同所有制企业数据分析

二、2019年中国晶圆制造所属行业不同所有制企业数据分析

三、2020年中国晶圆制造所属行业不同所有制企业数据分析

第五章 2020年中国晶圆市场深度剖析

第一节 2020年中国晶圆市场总况

一、晶圆加工企业规模及产能分析

二、晶圆的市场需求及增长情况

三、「HJ 327」晶圆市场供需形势

四、信息家电和通信产品需求旺盛对晶圆市场的推动

第二节 2020年中国晶圆市场价格分析

一、中国晶圆重点区域市场价格走势

二、影响价格因素分析

第六章 2020年中国晶圆市场竞争格局透析

第一节 2020年中国晶圆行业竞争现状

一、品牌竞争分析

二、价格竞争分析

三、营销方式竞争分析

第二节 2020年中国晶圆行业集中度分析

一、市场集中度分析

二、生产企业的集中分布

第三节 2020年中国晶圆行业竞争中存的问题

第四节 2021-2026年中国晶圆行业竞争趋势分析

第七章 中国晶圆优势生产企业竞争力分析

第一节 浙江金瑞泓

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

第二节 昆山中辰

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

第三节 北京有研总院

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

第四节 中国电科46所

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

第五节 淮安德科玛

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

第六节 华力微电子

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

第七节 北方华创

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

第八节 中微半导体

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

第九节 晶盛机电

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

第十节 盛美半导体

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

第八章 2021-2026年中国晶圆行业发展趋势与前景展望分析

第一节 2021-2026年中国晶圆行业发展前景分析

第二节 2021-2026年中国晶圆行业发展趋势分析

一、晶圆技术发展方向分析

二、晶圆技术与节能趋势

第三节 2021-2026年中国晶圆行业市场预测分析

一、晶圆行业市场产量预测分析

二、晶圆行业市场销量预测分析

第四节 2021-2026年中国晶圆市场盈利预测分析

第九章 2021-2026年中国晶圆行业投资战略研究

第一节 2020年中国晶圆投资概况（AKLT）

一、中国晶圆产业投资准入情况

二、国家扶持项目晶圆拉制项目

第二节 2021-2026年中国晶圆行业投资机会分析

一、晶圆重点区域投资潜力分析

二、与产业政策调整相关的投资机会分析

第三节 2021-2026年中国晶圆行业投资风险分析

一、宏观调控政策风险

二、市场竞争风险

三、技术风险

四、金融风险

第四节 行业投资建议

详细请访问：<https://www.huaon.com/channel/semicon/675787.html>